

株式会社アルバック

2018年度 決算説明会（2019年8月8日開催）

およびアナリストミーティングの主な質疑応答

【全体】

① 足下の事業環境と成長戦略について教えてほしい。

A：FPD 関連の投資は、大型 TV 用 LCD の商談が一巡し、当社客先の OLED の次の投資も来年度を見込むことから、当面は当社の受注という観点では踊り場となる。しかしながら、スマート社会化の進展に伴い今後は半導体電子を中心にアルバックの技術力が貢献できる分野が格段に広がってきており、中長期的な成長チャンスは大きいと考えている。エレクトロニクス分野での成長を実現するために、グローバルなリーディングカンパニーや最先端の研究所等との連携による開発体制の強化等も併せて進めている。（決算説明資料 P23 以降に「成長戦略」を掲載）

【2018年度連結業績】

② 18年度に計上した貸倒引当金はどのようなもので、いくらだったのか？リスク管理はどうなっているのか？

A：FPD・PV 関連の一部顧客で大口債権の回収不能懸念が生じたため、貸倒引当金 24 億円、棚卸資産評価損 4 億円の合計 28 億円を計上した。今回は特殊な装置で転用ができなかった特別なケース。引き続き与信管理体制強化を実施している。

③ OLED の追加原価はどの程度だったか？ 19年度は発生しないのか？

A：2月の業績修正開示時に約 30 億円程度の OLED 追加原価の可能性があると説明していたが数億円減少し、24 億円計上した。必要な手当ては行っており、今期（19年度）発生予定はない。

④ 18年度の品目別の営業利益率順位は？

A：1) コンポーネント 2) 半導体・電子 3) その他 4) 材料 5) 一般産業 6) FPD・PV
全体平均利益率は 3) その他 と 4) 材料 の間になる。

⑤ 18年度の売上が予想比未達だった理由は？

A：FPD 関連および半導体電子関連の一部の客先投資計画に今期への期ズレが発生したため。

【2019年度連結業績予想】

⑥ 19年度は貸倒引当金、OLED 追加原価が発生しないのであればもう少し利益率が高くなるのではないかと？

A：18年度に発生した貸倒引当金の影響は無くなるものの、将来に向けた研究開発費増加や開発関連の減価償却費増加等を見込んでいること、OLED 追加原価は無くなるものの、FPD の中で利益率が相対的に低い OLED 関連の売上比率が増すこと、売上減少の影響等から、予想でお示しているような利益率の改善を見込んでいる。

【FPD 関連】

⑦ FPD 投資の今後の見込みは？ 19 年度の FPD の受注・売上減少の背景は？

A：中国における大型 TV 用 LCD 工場は 2019～2021 年にかけて稼働開始予定だが、大型商談は一巡していること、当社客先のスマートフォン用 OLED 投資商談も来年度の可能性が高いことから、今年度の FPD 関連の受注・売上は端境期となり、低下を見込む。中国の大型 TV 用 LCD の本格稼働に伴い、韓国のパネルメーカーを中心に差別化のための中大型 OLED 投資（OLED 用途の拡大）の本格化が見込まれ、アルバックの強みを生かせると考えている。（決算説明会資料 11～12 参照）

⑧ 19 年度の OLED 投資とアルバックの受注見込みは？

A：中国におけるスマートフォン向けの OLED 投資は活発に行われるものと思われる。中国マーケットは日本の競合メーカーと客先を分け合っており、アルバックのお客様からは前期 3Q に受注しており、次の受注が来年度を見込んでいるため、受注金額は減少すると見込んでいる。

⑨ FPD 受注実績と受注予測の内訳は？

A：18 年度の受注実績は FPD 関連の 894 億円の受注のうち、LCD が 5 割弱（ほぼ大型用）、OLED 関連が 4 割強、その他が 1 割強。19 年度の受注予測は FPD 関連の 623 億円の受注のうち、LCD が 3 割強（ほぼ大型用）、OLED 関連が 5 割弱、その他が 2 割弱。

⑩ 19 年度の太陽光発電は？ 今後は？

A：高効率太陽光発電の設備投資計画は中国を中心に旺盛だが、投資採算を重視しており、競合との価格競争等も激しく、初期投資金額の抑制要請も強いことから、製造原価の半減が必要なため、中国生産で競争力を持たせようと考えている。市場としての広がり大きく、挑戦していきたい。

【半導体・電子関連】

⑪ 半導体メモリ投資の再開はいつ頃を見込んでいるのか？ 業績に効くのはいつからか？

A：2017～18 年にメモリ各社が活発な投資を行い、供給過剰となり、それまで急騰していた価格が大幅に下がった。このため、2018 年末より、メモリ各社は投資を延期し始めたが、当初は今年の半ばから再開が期待されていた。足下では、米中貿易摩擦等もあり、投資の本格的な再開は来年以降に持ち越しとなりそう。

⑫ 19 年度は半導体電子が伸びる計画だが何が伸びるのか？

A：DRAM 等メモリや PCRAM、ロジック、通信デバイスやセンサー、パワー半導体等が伸びる計画。

⑬ PCRAM 市場のポテンシャルは？

A：PCRAM は、DRAM 並みに処理スピードが速く、NAND と同様、電気が切れても記憶が可能なメモリで、データセンター等のサーバーの高速化・省エネ化実現に向け実用化されており、今後はエッジデバイス用 AI チップへの搭載等も期待されている。アルバックは、PCRAM 用量産成膜装置の唯一のサプライヤーであり、市場の成長とともにビジネス拡大するものと確信している。

⑭ ロジックの足元・今後の受注動向は？

A： 昨年度よりロジック分野で微細化最先端製品のスパッタリングプロセスにおいて新たに大手 2 社での採用が決定した。前期 4 Q にも受注が入っている。DRAM・NAND などメモリ市場と並ぶ規模の安定的な投資が見込めるロジック市場に初めて参入できたことは大きい。現状は客先半導体メーカーが微細化最先端製品のビジネスを開拓しているステージで本格的に大きな受注となるには少し時間がかかるが、DRAM・NAND と並ぶ規模に拡大させていく方針である。

⑮ 半導体電子の受注実績と受注予測の内訳は？

A： 18 年度の受注実績は半導体電子部品関連の 388 億円の受注のうち、メモリ関連が約 4 割、ロジックが 1 桁半ば、電子部品が 3 割弱、パワー半導体が 1 割半ば、実装が 1 桁半ば、LED 数%。
19 年度の受注予測は半導体電子部品関連の 501 億円の受注のうち、メモリ関連が 4 割弱、ロジックが 1 割弱、電子部品が 3 割強、パワー半導体が 1 割半ば、実装が 1 桁半ば、LED 数%。

⑯ 電子関連の今後の伸びが期待されるのはどの分野か？

A： 足下では、通信デバイスやセンサー関連、パワー半導体等が貢献しており、今後はこれらにパッケージング（実装）や光学膜分野等の拡大が見込まれる。

以上